

中国半导体行业协会半导体分立器件分会

中半器协 [2019]003 号

第十三届中国半导体行业协会半导体分立器件年会暨 2019 年中国半导体器件技术创新及产业发展论坛 第二轮会议通知

自 2019 年 4 月 24 日中国半导体行业协会以“中半协[2019]009 号”文发出《第十三届中国半导体行业协会半导体分立器件年会暨 2019 年中国半导体器件技术创新及产业发展论坛》第一轮会议通知以来，来自全国各地的产、学、研、用等单位积极支持，踊跃投稿，现会议的准备工作已经就绪，就会议细节和论文录用情况通知如下。

一、会议特邀报告

中国电子科技集团公司原副总经理	赵正平 研究员
国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟秘书长	于燮康 先生
西安电子科技大学微电子学院院长	张玉明 教授
电子科技大学集成电路研究中心主任	张波 教授
香港科技大学电子与计算机系	陈敬 教授
中国电子科技集团公司第十三研究所首席科学家	要志宏 研究员
华天科技集团技术总监	于大全 博士
中兴通讯股份有限公司射频功放平台总工	刘建利 先生

二、会议组织机构

- 主办单位：中国半导体行业协会
承办单位：中国半导体行业协会半导体分立器件分会
元器件封装技术创新中心
专用集成电路重点实验室
河北省新型半导体材料重点实验室（筹）
河北普兴电子科技股份有限公司
中国电子科技集团公司第十三研究所
协办单位：苏州纳米科技发展有限公司
山东半导体产业联盟
苏州市集成电路行业协会
江苏省半导体行业协会

陕西省半导体行业协会
 大连市半导体行业协会
 陕西半导体先导技术中心
 宽禁带半导体材料山西省重点实验室
 合肥锐拓科技信息服务有限公司
 青岛国翔会议展览服务有限公司
 《半导体技术》编辑部
 《微纳电子技术》编辑部

支持单位：



三、会议日程

1. 此次会议共录用论文摘要 139 篇，论文摘要都已经收入《论文集》，并将在参会者到会注册时发给每位参会者。希望每篇论文摘要（或论文）至少有一位作者参加会议。

由于来稿很多，研讨会时间有限，我们将根据具体情况选择安排在会上作报告的论文，并在事前与作者联系。

2. 7 月 23 日在青岛市黄岛区海都大酒店报到。会议议程安排如下：

时 间	地 点	主 题
7 月 24 日上午	海都大酒店乾悦厅	开幕式、特邀报告
7 月 24 日下午	海都大酒店乾悦厅	特邀报告
7 月 25 日上午	海都大酒店乾悦厅	技术研讨第一分会场
7 月 25 日下午	海都大酒店乾悦厅	
7 月 25 日上午	海都大酒店坤悦厅	技术研讨第二分会场
7 月 25 日下午	海都大酒店坤悦厅	

具体会议日程详见附件

四、会议时间、地点

1.会议时间：2019 年 7 月 23 日青岛黄岛海都大酒店报到，24 日、25 日开会。

2.会议地点：青岛市黄岛区长江中路 218 号。

距机场约 49 公里，乘车路线：机场—乘坐机场巴士黄岛（705 路）专线—在“黄岛区政府”下车，步行 900 米即到；

距青岛北站 35 公里，乘车路线：青岛北站—乘坐 325 路—在“中山路”下车，转乘隧道 3 路—在“机关东部办公中心”下车，步行 410 米即到；
距青岛站约 22 公里，乘车路线：青岛站—乘坐隧道 3 路—在“机关东部办公中心”下车，步行 450 米即到；
距青岛西站约 25 公里，乘车路线：黄岛 k22 路隐珠地铁站下车—乘地铁 13 号线—井冈山路（C 口出），步行 630 米即到。

会务组联系方式：

陆皓：13832163057；E-mail:luhao4168@vip.126.com；

李永：13933075237；0311-87091519；

传真：0311-87091477 E-mail: polaris13@vip.163.com；csiadd@126.com

